

股票代码：300657

股票简称：弘信电子

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2402

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国盛证券：刘高畅； 国盛证券：陈芷婧； 华西证券：胡 杨； 东吴证券：鲍娴颖； 招商基金：杨 成； 景顺长城基金：贡学博； 华泰柏瑞基金：刘志清； 横琴人寿：杨 路； 太平资产：陈祺麒； 鑫元基金：李 彪； 才华资本：胡誉镜。
时间	2024 年 10 月 16 日
地点	苏州线下
上市公司接待人员姓名	李强 、董博
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问算力下半年展望？ 公司上半年算力业务实现收入 11.07 亿元，整体趋势来看，下半年预期好于上半年。公司基于目前的市场情况作出相关分析，并于近期发布员工股权激励，激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度营业收入考核目标分别为 70 亿元/100 亿元/125 亿元，可作为公司整体经营目标的相关参考，但并不以此作为盈利预测和任何业绩指引。

2、软板的机会主要来自哪些方面？

主要是技术变革，未来因为运算强度以及语音交互等要求的提升，AI手机电池体积会增大增厚，挤占其他元器件的空间，使得部分软板必须变得更薄（从四层减至两层，FPC面积必须变大，进而增加了软板的使用量）以满足整体需求。因为AI技术革命性的发展，几乎所有消费电子，智能车，机器人等都需要结合AI重新做一遍，FPC将在小型化，柔性化，折叠化，紧凑型方面发挥关键作用。

公司的增长逻辑主要在于行业技术创新带来的大规模换机潮以及新兴领域的增量需求拓展。近几年国内软板产业因为内卷和价格下跌基本没有扩产，需求的进一步提升会导致国内头部厂商的产能不足，外资厂商的订单外溢，利好国内FPC头部企业。此外国内手机设计理念也会参照海外高端手机品牌，未来对软板的需求会进一步增多。

3、软板触底趋势是如何确认的？

2023年软板价格坠入谷底，与2017年公司上市时候的价格相差甚远，甚至不及材料成本，这是国内FPC企业普遍亏损的主要原因。现阶段市场价相比2023年有所上修，但是还是无法支撑企业正常盈利。随着供需关系发生变化，产品价格有望回归合理水平。

公司作为国内软板行业的主要参与者，专注于中高端产品，不再参与低价竞争，但是需要一定的时间。公司的稼动率在稳步提升，价格也有所修复，等到新的增量订单占整体订单的比例整体提升，届时价格有望修复到相对较高水平。

4、软板从接单到交付的节奏？

以智能手机为例，一个订单一般会延续一到两年，新增非低价订单是2024年下半年才陆续起量。2024年上半年交付还是以

2023 年上半年签订的合约为主，后续新订单占整体比例会逐渐增多。

5、请问公司目前的稼动率情况？公司业绩真正的拐点预期在什么时候会体现？

2024 年整体相对稳定，即稼动率在 50-60%区间范围内。目前公司软板的产能，足以支持营收的更进一步增长。公司稼动率在稳步提升的过程中，且伴随着随着新订单落地，价格亦同步修复，软板产能稼动率达到 80%将会是公司业绩的真正拐点。

6、请问软板的增量逻辑？

首先，拓展了新的应用领域，从智能手机逐渐向可穿戴设备、笔记本电脑、机器人、无人机、智能车车等拓展；再者科技变革，AI 革命带动，从功能和技术上不断带来新的增量。

7、请问未来价格展望？

公司的下游应用领域目前因为科技的更新，对整体软板的需求日益增多，新增订单快速增加。在整体行业产能不变的情况下，价格也在逐步修复。

8、请问笔记本电脑 AIPC 大客户的推进情况？

软板在 AI PC 上的应用主要是连接和信号控制部分，适应对高频高速的需求，AI PC 领域新增的单机价值量相对智能手机更加可观。公司目前在推进大客户的业务拓展。

9、请问安卓类手机厂商是否也像海外大厂一样有明确规划？

从总体趋势来看，智能手机（包括安卓类、鸿蒙系）的发展趋势有利于软板技术更新以及价格的修复。公司坚信量价都会有所改善。目前部分友商已经出现爆单情况。

10、请问 AIPC 的订单预期？

从长远角度看，AIPC 的需求具有比较可观的规模。笔记本电脑里面的 FPC 需求、价值量以及利润率情况均显著高于智能手机。

11、请问公司是否有服务器软板的业务？

公司具有软板以及整机服务器的加工制造能力，目前应用在服务器的软板正处在样品研发阶段，还没有进入批量生产的阶段。服务器软板对公司而言是新的增量市场，行业采用软板取代原来的硬板和部分线束,公司会着重投入研发并布局把握相关机遇。

12、请问公司在算力领域都提供什么样的销售或者服务？请简要介绍下公司算力业务在东部的进展？

公司 AI 业务的战略目标，是成为算力硬件和整体解决方案提供商。公司在该领域形成了完整的商业闭环以及丰富的关键资源与软硬件能力，可为客户参与算力投资提供包括算力芯片采购、服务器整机生产制造、大改装，改配、大规模组网、Gpu 运行状态监测、算力调度与运营管理、维保、算力消纳等全方位服务，形成一体化高效解决方案，持续强化与客户的黏性，以大幅提升核心竞争力水平和产业护城河。

在东部地区，公司目前与某头部大模型厂商深度合作，为该模型厂的算力供应提供了重要的算力保障以及组网、运维等的持续性技术服务。

公司认为目前算力领域的核心竞争力已经从获卡逐渐演进到大规模组网运营以及算力调度等高技术、高附加值的整体解决方案，客户需要综合技术能力更强，资金能力更强的服务商，目前公司具有这样的技术能力、资金能力以及拥有诸多成功运行的标

	<p>杆案例。</p> <p>13、公司如何评价算力需求？</p> <p>目前算力板块正在经历巨大的行业变革，大部分需求会逐渐向头部客户转移，使得行业的重要订单主要集中在具有相关技术实力的大型互联网厂商以及大模型公司。从海内外的整体需求对比来看，目前美国整体的资本支出远远大于中国，中国相关算力厂商未来的体量还有非常大的成长空间。随着新应用的推出、发展以及终端硬件的更新，公司会继续乘风破浪，促进软板业务和算力业务的深度融合，致力于成为算力硬件和算力整体解决方案提供商，实现公司的 All in AI 战略宏伟目标。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 10 月 16 日